

진공 도금(IVD)

코텍은 다양한 표면처리기술을 전문적으로 보유하고 있으며 다양한 표면처리품목 생산을 위한 개발과 품질관리에 힘쓰고 있습니다.



생산 품목 및 적용

| | | | |
|--------------------|--|---------------------------|--|
| 전 80 mm 적 | MIL-DTL-83488 PS13143 (Al Plating) | 등급 | Class 1 : 26 μm ↑ Class 2 : 13~26 μm Class 3 : 8~13 μm |
| | | 유형 | Type I : 코팅상태 그대로 Type II : 크로메이트 보조처리 |
| | AMS-C-8837 PS13145 (CD Plating) | 등급 | Class 1 : 최소 13μm Class 2 : 최소 8μm Class 3 : 최소 5μm |
| | | 유형 | Type I : 도금상태 그대로 Type II : 보조 크로메이트 처리 |
| 승인현황 | 국외기업 | BOEING, BOMBARDIER | |
| | 국내기업 | KAI, 한화테크엠, 대한항공, 국방과학연구소 | |

설비현황

| | |
|----------|------------------|
| (주)에어로코텍 | 1,300 × 2,500 mm |
|----------|------------------|

진공 도금(IVD)

복잡한 형상 부분 작업 가능

보유기술별 특성 및 적용제품

대상품목

- 항공부품 및 전기전자부품
- MAGNET 등의 소결제품
- 고강도용 BOLT 및 STAINLESS STEEL BOLT 대체목적, 기타 BOLT와 NUT, SPRING, WASHER와 PIN 등의 HARDWARE류
- 아노다이징 대체 알루미늄 합금구조물, STEEL, STAINLESS STEEL, TITANIUM, POWDER METALS
- 카드뮴 도금 대체 및 기타 도금 대체 목적

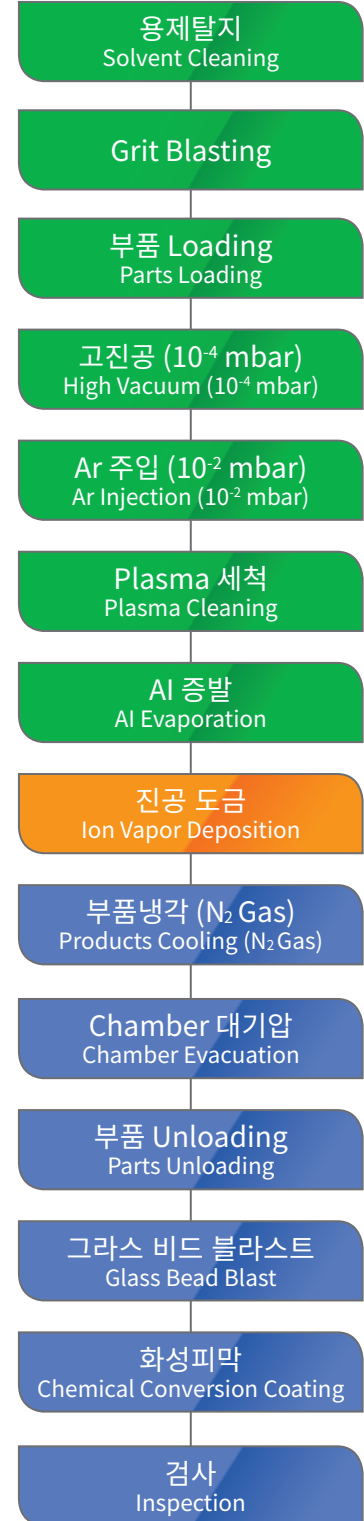
용도

- 유황성분류, 염기류, 유기물질류 등의 산업공해 물질에 의해 부식이 발생하는 곳과 이질 금속간의 전기적 부식이 발생하는 곳
- 전자파간섭(EMI)방지 목적
- 고온부식 및 전기부식이 일어나기 쉬운 곳
- 수소 취성(Hydrogen Embrittlement)이 없어야 하는 곳
- 연료 및 인화성 재료 접촉면에 사용가능
- 열 교환 장치
- 용도에 맞는 착색이 필요한 곳(Decoration)

코텍 도금 공정



공정도



위 도금공정은 주식회사 코텍의 콘텐츠이므로 무단복제 및 도용을 금합니다. 본 콘텐츠를 사용하시려면 별도로 문의를 바랍니다.